

可靠性实验参考表 (通用版)

序号	试验项目 (Test Item)	试验条件 (Condition)	参考标准 (Reference)	实验时间 (Time)	适用范围 (Scope)
1	预处理 (Pre-conditioning)	Performed on surface mount devices (SMDs) prior to TC,AC, H3TRB/HAST & IOL/PCT stresses only.	JESD22A-113	1.Temperature Cycling: -40°C~60°C, 5cycles; 2.Bake: 125°C,24H; 3.Moisture Soak: 85±2°C, 85±5%/168h; 4.Reflow*3cycles: 260°C,3cycles time 5-60min	Only For SMD Series 仅适用于贴片系列
2	高温反偏 (High Temperature Reverse Bias)	Tjmax,80%VR Tjmax,100%VR(Only For AECQ)	JESD22-A108	1000Hrs	All Series 所有系列
3	间歇老化 (Intermittent Operational Life )	△Tj≥100°C,2min ON/2min OFF	MIL-STD-750 Method 1037	15000Cycles	Except for TVS&Zener Series TVS&Zener 不适用
4	高温高湿反偏 (High-temperature High-humidity Reverse Bias)	85±2°C, 85%±5%RH, 80%VR (Max=100V)	JESD22-A101	1000Hrs	All Series 所有系列
5	高加速寿命实验 (Highly Accelerated Stress Test)	130±2°C, 85%±5%RH 80%VR (Max=42V)	JESD22-A110	96Hrs	All Series 所有系列
6	高温高湿 (High-temperature High-humidity storage test)	85±2°C, 85±5%RH	MIL-STD-202F METHOD-103B	1000Hrs	All Series 所有系列
7	温度循环试验 (Temperature Cycling)	150°C (+15, -0) /15min, -55°C (+0, -10) /15min	JESD22-A104	1000 cycles	All Series 所有系列
8	高温储存 (High Temperature Storage)	150±2°C	JESD22-A103	1000Hrs	All Series 所有系列
9	低温储存 (Low Temperature storage)	-55±2°C	Specification	1000Hrs	All Series 所有系列
10	高压蒸煮 (Auto-clave)	121°C±2°C,15 psig, 100%RH	JESD22-A102	96Hrs	All Series 所有系列
11	盐雾试验 (Salt Spray Test)	试验温度: 35±2°C, 氯化钠盐水浓度: 5±0.1%, PH值范围: 6.5-7.2, 沉降率: 1~2ml/80cm².h	GB/T 2423.17-2008	24Hrs	All Series 所有系列
12	易焊性试验 (Solderability)	245°C±5°C	JESD22-B102	3sec	All Series 所有系列
13	耐焊接热 (Resistance to solder heat)	DIP: 270±5°C SMD: 260°C(+5,-0)	JESD22-B106 JESD22-A111	DIP: 7sec(+2, -0) SMD :10sec	All Series 所有系列
14	正向浪涌试验 (Forward Surge Test)	8.3ms,Single,Half -Wave	MIL-STD-750 Method 4066	5Times	All Series 所有系列
15	静电测试 (ESD)	HBM: 100pF,1500Ω ,GPP:4KV; Others:2KV; MM: 200pF,0Ω ,400V	AEC-Q101-001/002	1cycle	All Series 所有系列